

第一次配信

2007年(平成19年)度 半導体製造装置 日本製装置

作成日: 2007年9月25日

(社)日本半導体製造装置協会

〔表1〕 受注高

(単位: 百万円)

装置大分類	年月	2006/9月	10月	11月	12月	2007/1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	2007年度累計 07.4~07.9	2006年度累計 06.4~06.9	前年同期比 2007/2006年度
A. 半導体設計用装置		1	4	0	11	0	7	3	0	1	2	3	1	14	21	8	162.5%
B. マスク・レチクル製造用装置		11,565	470	1,943	10,292	511	805	1,536	2,494	257	2,486	665	545	2,127	8,574	19,203	-55.4%
C. ウェーハ製造用装置		1,874	1,443	1,319	1,156	1,352	1,495	2,160	1,054	1,526	2,793	1,196	1,584	777	8,930	11,317	-21.1%
D. ウェーハプロセス用処理装置		136,724	103,377	100,642	151,297	184,637	103,474	110,476	117,226	113,304	104,918	95,291	98,387	77,544	606,670	717,931	-15.5%
E. 組立用装置		8,805	9,421	12,304	13,733	11,382	9,908	11,272	9,365	10,835	11,152	10,396	12,958	11,348	66,054	60,071	10.0%
F. 検査用装置		34,455	17,007	27,190	36,176	18,192	26,165	48,195	18,993	28,301	21,682	16,042	21,130	22,430	128,578	175,756	-26.8%
G. 半導体製造装置用関連装置		14,009	6,591	4,251	5,617	4,100	6,416	8,835	6,306	6,375	7,569	6,381	3,839	5,311	35,781	34,272	-25.9%
合計		207,433	138,313	147,649	218,282	220,174	148,270	182,477	155,438	160,599	150,602	129,974	138,444	119,551	854,608	1,032,567	-17.2%
前年度実績		134,670	134,362	130,994	151,839	137,442	146,885	184,547	155,700	167,264	203,161	148,174	150,835	207,433	1,032,567		
前年同期比		54.0%	2.9%	12.7%	43.8%	60.2%	0.9%	-1.1%	-0.2%	-4.0%	-25.9%	-12.3%	-8.2%	-42.4%	-17.2%		

〔表2〕 販売高

(単位: 百万円)

装置大分類	年月	2006/9月	10月	11月	12月	2007/1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	2007年度累計 07.4~07.9	2006年度累計 06.4~06.9	前年同期比 2007/2006年度
A. 半導体設計用装置		2	5	2	2	2	2	3	3	2	2	4	3	3	17	9	88.9%
B. マスク・レチクル製造用装置		3,780	229	2,057	3,660	2,736	2,754	6,455	357	3,842	2,329	220	3,323	3,904	13,975	12,850	8.8%
C. ウェーハ製造用装置		1,910	1,654	1,194	1,904	1,294	2,775	2,251	1,301	1,086	1,442	1,470	1,394	2,126	8,819	6,705	31.5%
D. ウェーハプロセス用処理装置		116,130	88,618	93,302	121,566	97,145	97,265	163,829	84,311	111,043	125,861	123,264	131,226	131,089	706,794	527,838	33.9%
E. 組立用装置		13,373	8,395	8,366	12,237	9,014	9,986	19,174	8,556	9,134	13,378	11,386	11,608	14,387	68,449	60,836	12.5%
F. 検査用装置		32,369	19,736	25,458	26,189	23,124	23,751	48,662	19,701	26,054	30,267	22,243	24,024	28,523	150,812	175,478	-14.1%
G. 半導体製造装置用関連装置		9,613	3,649	6,676	4,077	5,138	4,276	15,240	5,729	4,945	6,159	5,244	3,470	9,466	35,013	30,202	15.9%
合計		177,177	122,286	137,055	169,635	138,453	140,809	255,614	119,958	156,106	179,438	163,831	175,048	189,498	983,879	813,918	20.9%
前年度実績		170,310	89,467	121,574	139,577	122,162	120,093	232,964	88,845	114,957	141,239	144,246	147,454	177,177	813,918		
前年同期比		4.0%	36.7%	12.7%	21.5%	13.3%	17.2%	9.7%	35.0%	35.8%	27.0%	13.6%	18.7%	7.0%	20.9%		

注意 : 当協会事務局の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表又は公表を補助することを禁止します。(日本製装置 = 国内向日系企業製装置 + 海外向日系企業製装置)

半導体製造装置の B/B レシオ

	9月	10月	11月	12月	07/1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
日本製装置 全装置合計	1.08	1.11	1.13	1.18	1.32	1.31	1.03	0.94	0.94	1.02	0.88	0.81	0.73

B/Bレシオの算出に当たっては、受注高・販売高の3ヶ月移動平均データを使用しています。